5G用低誘電プリント基板材料

Low-Dk Material for 5G PCB/FPC

Fluon+™ EA2000

“フッ素樹脂は密着しない”という既成概念を覆す接着性フッ素樹脂「Fluon+™ EA-2000」。優れた電気特性はそのまま、従来のフッ素樹脂が持つ、多層化しにくい、メッキがのりにくい、といった加工上の課題を改善しました。

Fluon+™ EA-2000 is “sticking Fluoropolymer” with excellent electric properties which enables multi-layering and metal plating in PCB/FPC producing process.

■ 製品の特長／Feature of Product

- 耐熱性、電気特性などフッ素樹脂の優れた特性を維持しつつ、接着性・分散性をプラスした製品です。
- AGC was successful to add adhessiveness and dispersibility on the top of primary Fluoropolymer properties such as heat resistance, remarkable electrical properties.

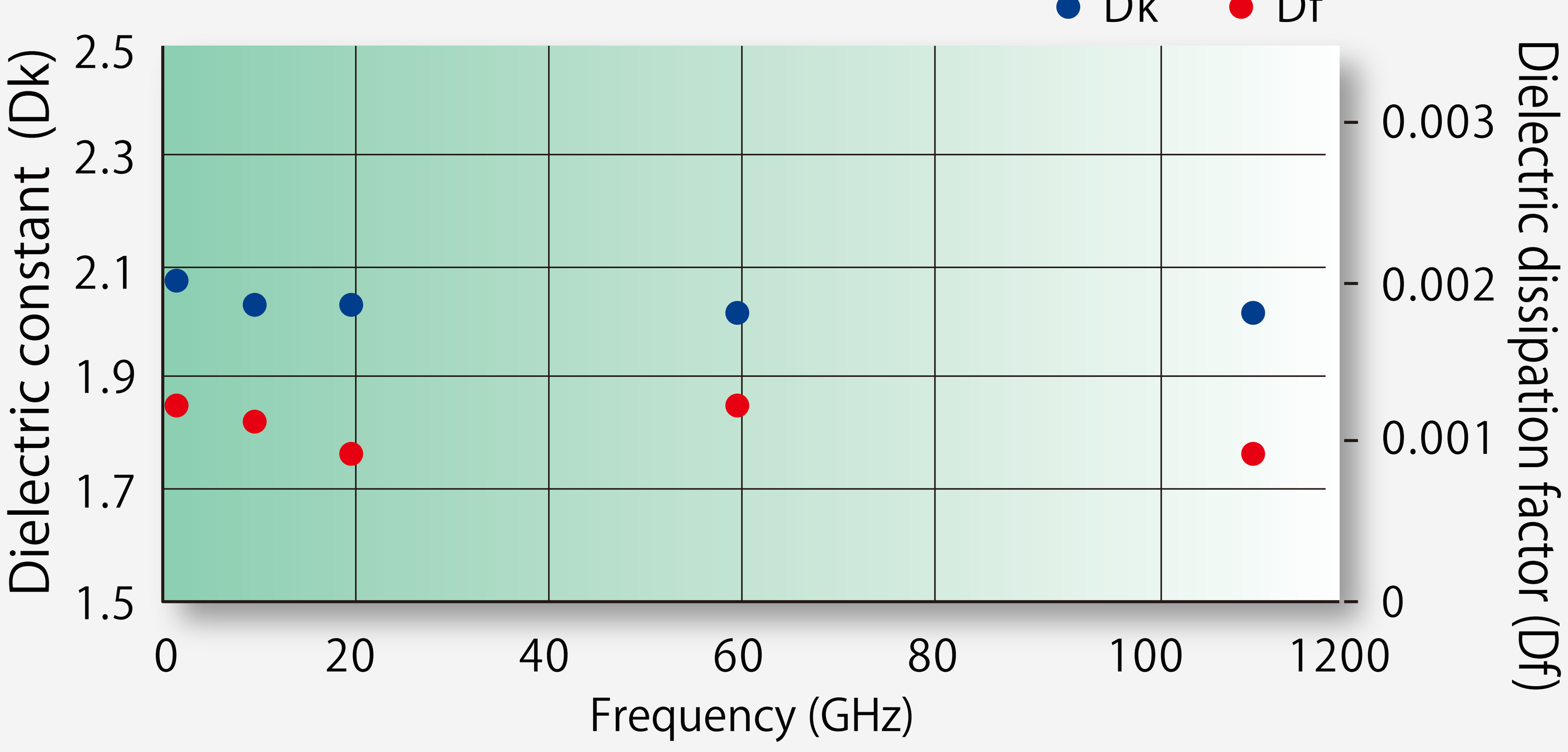
■ 用途例／Application

- CCL/FCCL材料
- Material for CCL/FCCL

■ 製品概要／Product Summary

既存材料に比べ大幅に伝送損失を低減することが可能。CCL、FCCL共に適用可能なため、スマートフォンなどのモバイル機器、基地局、サーバー、車載用など、様々なプリント基板に展開可能です。

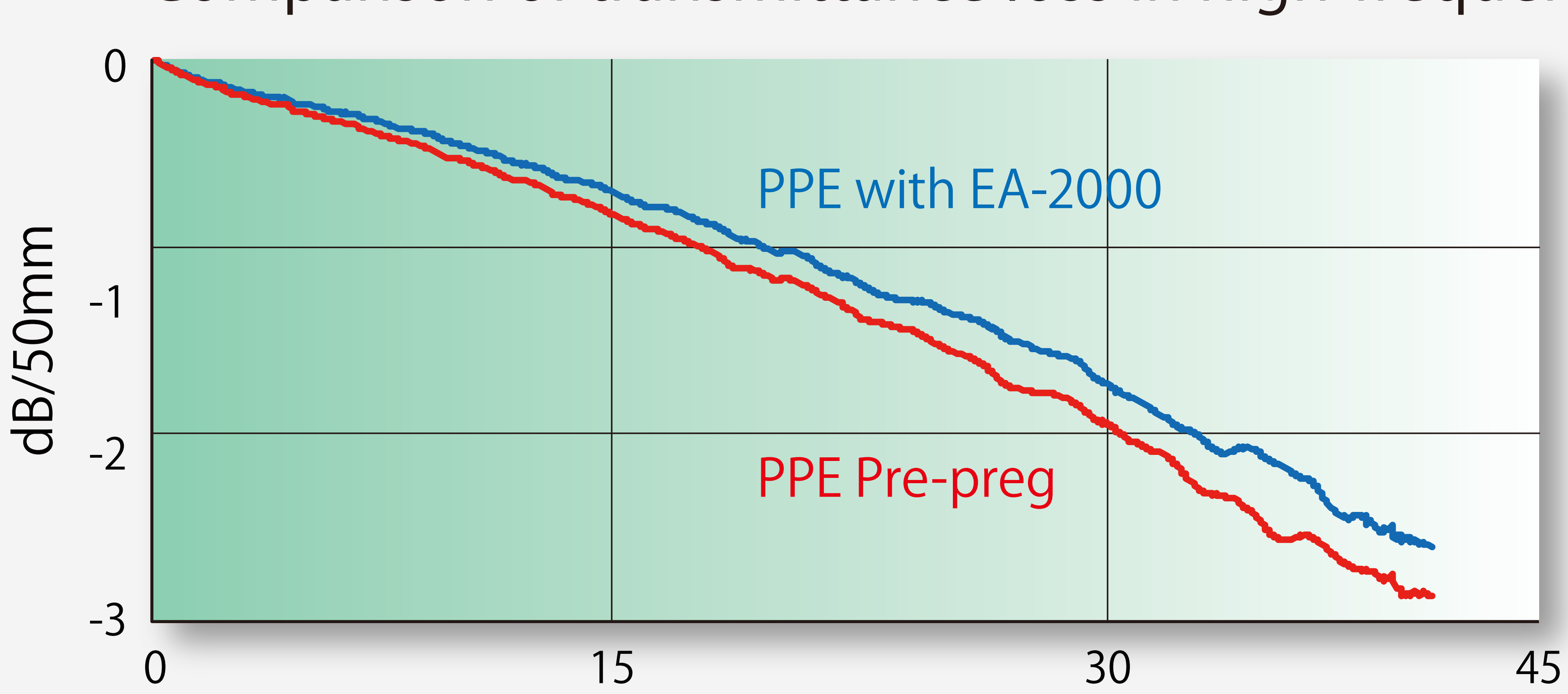
DK and DF



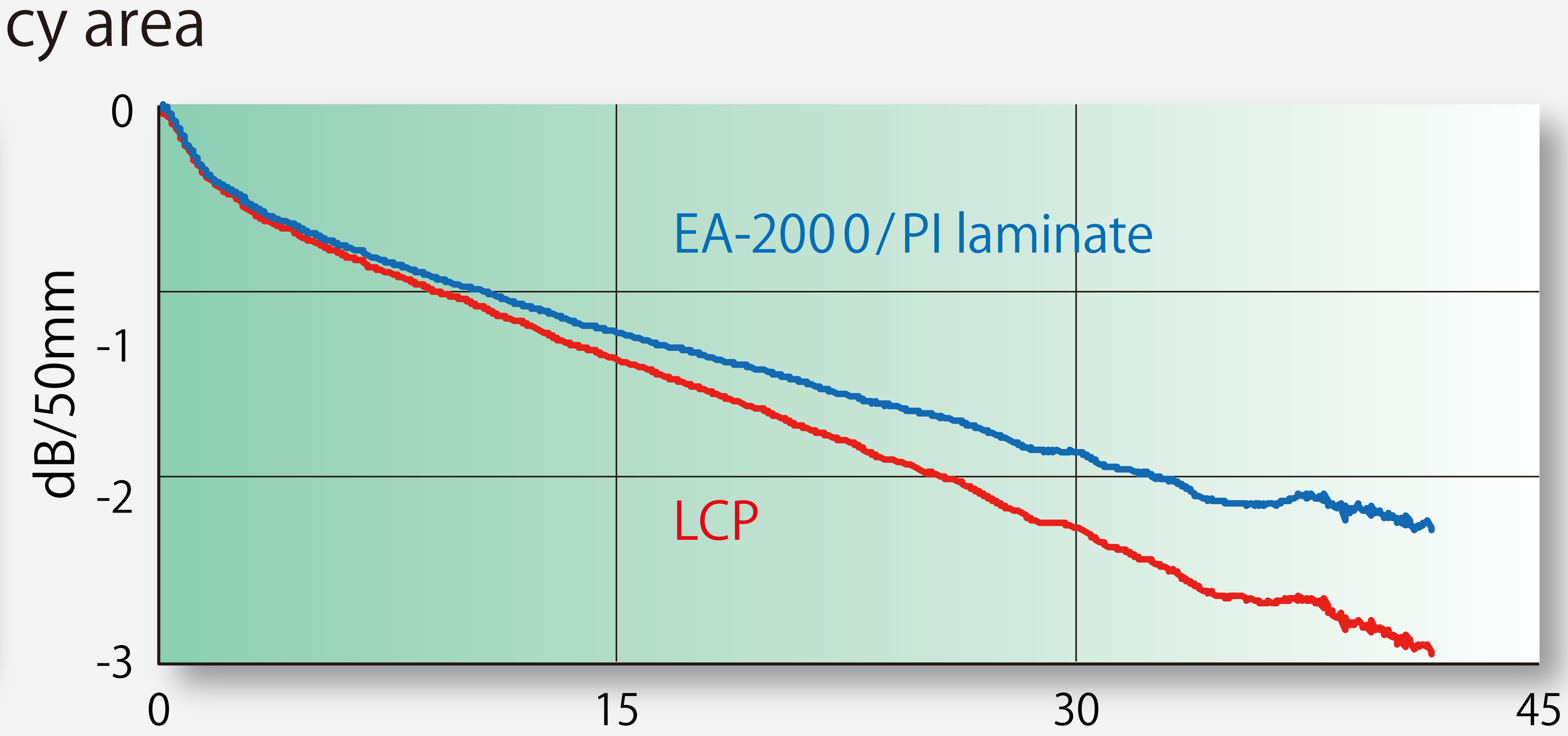
Adhesiveness toward copper foil

	Roughness (Rz)	Peeling strength (kN/m)
Electrolytic copper foil（ED）	1.2μm	>1.0
Rolled copper foil（RA）	0.6μm	>1.0

Comparison of transmittance loss in high-frequency area



EA-2000 reduces 15% loss @28GHz



EA-2000 reduces 17% loss @28GHz